

ASPS

2023

Advanced
SEMICONDUCTOR
PACKAGING
Show

차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전

2023 8.30(Wed) - 9.1(Fri)
Suwon Convention Center



Advanced SEMICONDUCTOR PACKAGING Show

Why 반도체 패키징?

최근 글로벌 반도체 수급난 가열과 함께 반도체 관련 제품의 성능 향상으로 인하여, 반도체 후공정 및 패키징 공정의 중요성이 나날이 대두되고 있습니다.

아직 반도체 패키징 산업은 초기 단계에 있으며, 최첨단 반도체 패키징 기술의 선제 도입은 미래 글로벌 시장 주도권 경쟁에 중요한 화두가 될 것입니다.

이에 차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전(ASPS)은 최신 반도체 패키징 글로벌 트렌드 및 응용 장비, 재료, 기술 솔루션을 선보일 수 있는 반도체 후공정 전문 전시회로, 반도체 관련 최적의 입지조건을 갖추고 있는 수원컨벤션센터에서 2023년 8월 30일부터 9월 1일까지 개최합니다.

처음 개최되는 반도체 패키징 전문 전시회인 만큼, 기존 반도체 전시회보다 전문적이고, 차별화 된 전시회를 선보일 예정입니다.

반도체 패키징 산업의 미래와 함께할 귀사를 본 차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전에 초대하오니, 많은 참가 바랍니다.



Why 수원컨벤션센터?

화성, 용인, 평택, 오산, 이천, 성남, 수원, 안성
경기 남부 '스마트 반도체 도시 연합' 결성!



Advanced SEMICONDUCTOR PACKAGING Show

전시회 개요

명 칭 2023 차세대 반도체 패키징 장비재료 산업전
Advanced Semiconductor Packaging Show 2023

약 칭 ASPS 2023

기 간 2023년 8월 30일(수) - 9월 1일(금)

시 간 10:00 - 17:00 (금요일 16:30)

장 소 수원컨벤션센터

규 모 120개사, 450부스, 관람객 10,000명 (예상)

주 최 경기도, 수원시

주 관 (주)제이엑스포, (재)수원컨벤션센터, 전자신문

후 원 한국실장산업협회, 수원상공회의소, 한국전자기술연구원,
한국마이크로전자및패키징학회, 소부장기술융합포럼,
한국마이크로전자패키징연구조합

부대 행사 차세대 반도체 패키징 컨퍼런스
참가업체 기술세미나
반도체 패키징 심포지움

참가업체 전시 품목

반도체 패키징 설계기술

반도체 패키징 소재기술

반도체 패키징 공정기술

반도체 패키징 장비기술

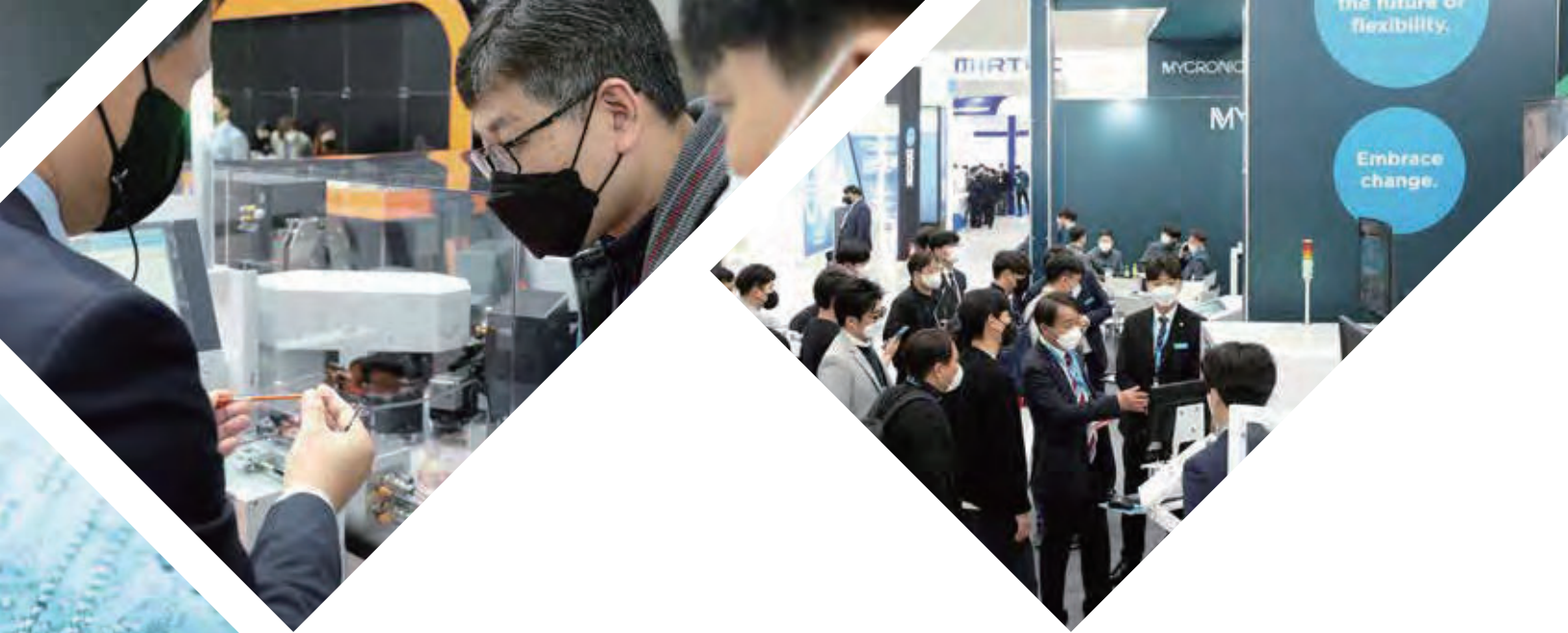


관람객 프로필

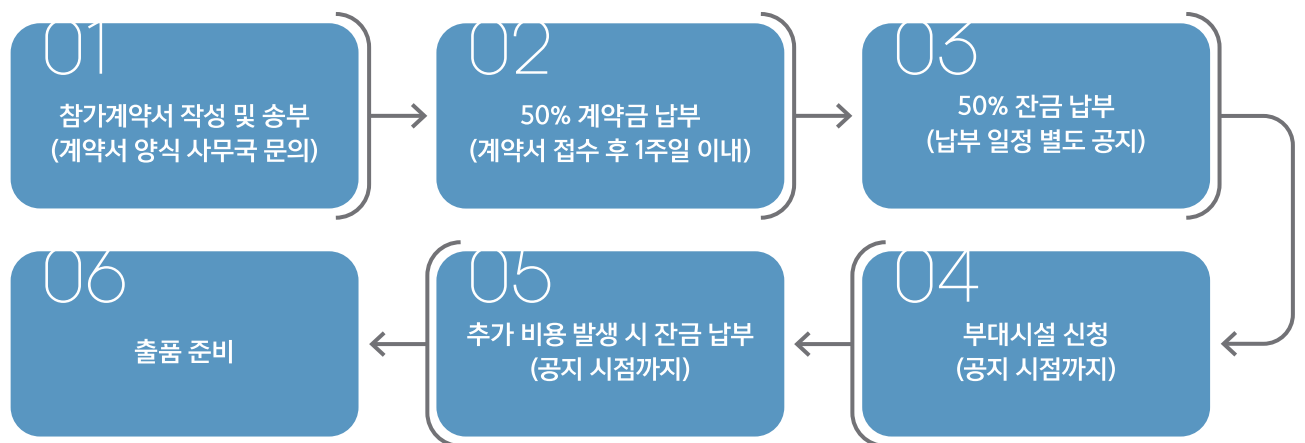
- 해외 및 국내 OSAT사
- 국내외 종합 반도체사
- 전자/자동차/IT 관련 제조사 및 연구 개발사

부대행사

- 차세대 반도체 패키징 컨퍼런스
- 참가업체 기술세미나
- 반도체 패키징 심포지움



참가 절차



참가비 안내

 <h3>독립 부스</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 전시 면적만 제공 • 공식 시공사 섭외 필수 • 최소 신청 단위 = 2부스 • 참가비 252만원 / 부스 	 <h3>기본 부스</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 베이직 조립 타입 부스 • 기본 패키지 포함 • 최소 신청 단위 = 1부스 • 참가비 297만원 / 부스 	 <h3>프리미엄 부스</h3> <ul style="list-style-type: none"> • 프리미엄 블록 타입 부스 • 프리미엄 패키지 포함 • 최소 신청 단위 = 2부스 • 참가비 402만원 / 부스
--	--	---

※ 1부스 = 9sqm



Advanced SEMICONDUCTOR PACKAGING Show

참가 문의처 | Contact

(주)제이엑스포 | J. Expo Ltd.

T. 02-6285-9131

E. semipkgshow@jexpo.or.kr